

倒角

High performance Edge Grinder

高效率晶圆倒角设备



难削材高精度研削

高产能配备双轴式

第三/四代研磨设备

第三代



SiC, GaN

第四代



Diamond, AlN

## 加工平台



## 加工精度

项目	加工精度
直径	±10μm以内
定位边宽度	±25μm 以内
定位边方向	±0.03°以内
定位边直线性	≤10μm
圆形度	≤20μm
面宽	±15μm以内
Notch深度	±15μm

## 基本规格

项目	基本规格
设备模式	全自动设备 可放入4~8个cassette
加工对象	SiC等化合物半导体晶片、Si晶片等, 可加工圆周、定位边及Notch
晶片尺寸及厚度	6英寸、8英寸 0.25mm~2.0mm
加工轴数	2个 (独立控制)
砂轮种类	T型、R型、T&T型、T&R型 (加工Notch用的砂轮只有T型、R型)
砂轮尺寸	厚20mm 外径Φ202mm, 内径Φ30mm 加工Notch用的砂轮 外径 3mm

项目	基本规格
砂轮沟数	可根据客户要求定制
砂轮转速	加工外周时 1,000~5,000rpm (变频控制)
	加工Notch时 6,000rpm
晶片转速	加工圆周时 1~50mm/sec
	加工定位边时 1~20mm/sec 加工Notch时 晶片基本不动
冷却水/研削水	普通自来水或纯水
清洗装置	可对加工后的晶片做简单清洗
※可对各项目的参数进行设定	

